

501**ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW**

z dnia 16 maja 2000 r.

w sprawie zawieszenia pobierania cel od niektórych towarów.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. zawiesza się pobieranie cel określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1217 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 277

i Nr 29, poz. 361), w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2. Stawki celne zawieszono stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

Kod PCN	Wyszczególnienie	Zawieszenie obniżonych stawek celnych:												
		UE	EFTA	Czechy i Słowacja	Węgry	Słowenia	Rumunia	Bulgaria	Litwa	Lotwa	Estonia	Izrael	Wyspy Owcze	Turcja
9027 80	kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku, łącznie ze światłomierzami; mikrotomy: — Pozostałe przyrządy i aparaty: -- Elektroniczne													
9027 80 13 0	--- Urządzenia do przeprowadzania pomiarów właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych lub podłoży wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, lub związanych z nimi warstw izolacyjnych i przewodzących podczas procesu produkcji płytek półprzewodnikowych, lub podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych													
ex 9027 80 13 0	Urządzenia do przeprowadzania pomiarów właściwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych lub związanych z nimi warstw izolacyjnych i przewodzących podczas produkcji płytek półprzewodnikowych													

ex